

Title (en)

CONTACT WITH A SILVER CONTACT BASE AND PROCESS FOR MAKING IT.

Title (de)

KONTAKTSTÜCK MIT EINER SCHALTSILBER-KONTAKTAUFLAGE UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG.

Title (fr)

CONTACT AVEC UN REVETEMENT DE CONTACT EN ARGENT ET PROCEDE POUR SA FABRICATION.

Publication

EP 0615651 A1 19940921 (DE)

Application

EP 92923688 A 19921130

Priority

- DE 4139998 A 19911204
- DE 9200998 W 19921130

Abstract (en)

[origin: WO9311550A1] There are various processes for making such silver contact bases which, however, are either very laborious in the manipulation of the silver contact base and intermediate layer, the contact plate and the contact bearer and their soldering or are based on strip material of suitable composition, rolling these strips on one another and cutting the edges. In the latter process, noble metal is wasted. To avoid these drawbacks, according to the invention the solder is applied in the form of a platelet (6) before the actual process on the intermediate silver layer (4). Here it is especially advantageous if this application is made by ultrasonic soldering. The invention is applicable to all silver contacts.

Abstract (fr)

Il existe différents procédés de fabrication de ces revêtements de contact en argent mais ces procédés comportent des opérations de manipulation du revêtement de contact en argent, de la couche intermédiaire en argent, de la plaque de contact et du porte-contact ainsi que des opérations de soudage de ces pièces qui sont très fastidieuses, ou bien ils consistent à employer en premier lieu un matériau en bande de composition appropriée, à laminer ces bandes l'une sur l'autre et à découper leurs bords. Ce dernier procédé produit cependant des déchets de métal noble. Pour éviter ces inconvénients, il est prévu dans l'invention que la soudure sous la forme d'une plaque (6) soit fixée sur la couche intermédiaire d'argent (4) avant le processus proprement dit. Il est particulièrement avantageux que cette fixation s'effectue par soudage aux ultrasons. L'invention s'applique à tous les contacts en argent.

IPC 1-7

H01H 11/04

IPC 8 full level

H01H 1/023 (2006.01); **H01H 11/04** (2006.01); **H01H 11/06** (2006.01)

CPC (source: EP US)

H01H 1/0231 (2013.01 - EP US); **H01H 11/045** (2013.01 - EP US); **Y10T 29/49213** (2015.01 - EP US); **Y10T 29/53896** (2015.01 - EP US); **Y10T 29/539** (2015.01 - EP US)

Citation (search report)

See references of WO 9311550A1

Designated contracting state (EPC)

CH DE ES FR GB GR IT LI PT SE

DOCDB simple family (publication)

WO 9311550 A1 19930610; BR 9206854 A 19951205; DE 4139998 A1 19930609; DE 59202048 D1 19950601; EP 0615651 A1 19940921; EP 0615651 B1 19950426; ES 2071517 T3 19950616; JP H07501646 A 19950216; US 5598629 A 19970204; US 5799771 A 19980901

DOCDB simple family (application)

DE 9200998 W 19921130; BR 9206854 A 19921130; DE 4139998 A 19911204; DE 59202048 T 19921130; EP 92923688 A 19921130; ES 92923688 T 19921130; JP 50970293 A 19921130; US 25412894 A 19940606; US 74550296 A 19961112